

上游存储价格涨势趋缓 手机厂商业绩仍未明朗

本报记者 陈佳岚 深圳报道

从2023年第三季度开始，三星、海力士等存储原厂通过控制产量、涨价，叠加下游逐渐复苏、高性能存储需求升温等因素，存储行业进入涨价周期。以DRAM（动态随机存取存储器，内存）为例，今年内存产业已经连续多个季度营收被推高了。

11月26日，根据TrendForce集邦咨询最新调研研报，2024年第三季度DRAM产业营收为260.2亿美元，季增13.6%。《中国经营报》记者梳理TrendForce集邦咨询此前披露的内存产业研报留意到，DRAM产业营收已经连续多个季度呈环比增长态

存储企业营收持续提升

国内外多家存储芯片企业在今年第三季度实现了营收与净利润的双双大幅增长。

存储芯片作为半导体行业的风向标，在2023年第三季度率先启动价格上涨。本轮价格上涨中，DRAM和NANDFlash（闪存存储器）价格累计涨幅约为60%至70%，年内涨幅达50%至60%。

存储原厂的营收也被持续推高，三星电子今年第三季度总营收达79.1万亿韩元（约573亿美元），同比增长17.3%，环比增长7%；海力士第三季度营业收入为17.57万亿韩元，环比增长7%，同比增长94%，创历史新高。美光科技2024财年第四财季财报季度营收为77.5亿美元，同比增长93.27%，环比上个季度增长了13.79%，营收连续多个季度增长。

与此同时，今年以来，A股多家存储芯片上市公司在涨价趋势下业绩普遍向好。截至今年第三季度，佰维存储（688525.SH）在2024年前三季度实现营业收入50.25亿元，同比增长136.76%；归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，同比增长147.13%。其中第三季度单季度营业收入15.84亿元，同比增长62.64%，归母净利润亏损5524.45万元，但同比

增长了70.54%。

澜起科技（688008.SH）前三季度实现营业收入25.71亿元，同比增长68.56%；实现归属于上市公司股东的净利润9.78亿元，同比增长318.42%。其中第三季度实现营业收入9.06亿元，同比增长51.60%；归母净利润为3.85亿元，同比增长153.40%。

值得注意的是，消费级存储芯片价格在连续多个季度上涨之后，有的也已经在回落了。而降价反映到终端产品上可能还需要一段时间。

增长70.54%。

澜起科技（688008.SH）前三季度实现营业收入25.71亿元，同比增长68.56%；实现归属于上市公司股东的净利润9.78亿元，同比增长318.42%。其中第三季度实现营业收入9.06亿元，同比增长51.60%；归母净利润为3.85亿元，同比增长153.40%。

兆易创新前三季度实现营业收入56.50亿元，同比增长28.56%；归母净利润8.32亿元，同比增长91.87%。其中第三季度单季度营业收入20.41亿元人民币，同比增长42.83%；单季度归母净利润3.15亿元，同比增长222.55%。

记者梳理发现，佰维存储、江波龙（301308.SZ）、兆易创新、澜起科技、聚辰股份（688123.SH）、德明利（001309.SZ）、东芯股份（688110.SH）、普冉股份（688766.SH）、恒烁股份（688416.SH）等存储企业2024年第三季度营收与净利润皆实现同比双位数增长，不过，部分企业如佰维存储、江波龙、澜起科技、聚辰股份、普冉股份、恒烁股份营收也出现了季度环比下滑的情况。

手机厂商成本承压

谈及智能手机毛利率的波动，小米集团合伙人、总裁卢伟冰在财报电话会议上解释，这主要是因为第三季度内存价格比较高，以及产品发布周期对季度毛利率的影响。

“今年一季度，存储产业确实达到了一个相对的高峰。然而，一季度之后市场出现了显著的分水岭。在二季度和三季度，随着人工智能技术应用的不断推进，存储产品的价格每个季度都在创新高。近期，几大存储原厂公布的财报业绩均创下新高。在全球经济并不景气的大环境下，存储产业的表现可谓独树一帜，却给终端手机企业带来了更大的经营和成本压力。可以看到，一些手机厂商公布的三季度财报并不理想，在成本不断上升的情况下，给市场泼了一盆冷水。”谈及今年的存储市场行情，倪黄忠用“冰火两重天”来形容。

11月18日，小米集团（1810.HK）发布的第三季度财报显示，今年第三季度，小米智能手机业务的收入为475亿元人民币，同比增长13.9%，公司智能手机ASP（平均售价）由2023年第三季度的每部997.0元上涨10.6%至每部1102.2元，最终带动收入同比增长13.9%，

第四季度部分手机存储价格已回落

随着NAND价格下探，手机市场可以更游刃有余地备货，放心大胆地布局产品。

在存储产品连续多个季度价格上涨之后，智能手机厂商已再难接受大幅度涨价了，部分存储器产品合约、现货市场也已经出现价格上涨动能回落，甚至是价格季度环比下降的情况了。

TrendForce集邦咨询资深研究副经理吴雅婷表示，在智能手机厂商整体对存储产品进行去库存的动作下可以看到，智能手机内存价格在第三季度出现季度价格环比持平的情况。需要留意的是，2024年第三季度，尽管存储产业受到手机厂商去库存及部分DRAM供应商扩产影响，DRAM原厂LPDDR4及DDR4出货量下降，但供应数据中心的DDR5及HBM（高带宽内存）需求上升仍在推动2024年第三季度DRAM产业营收达260.2亿美元，平均销售单价部分，三大原厂延续前一季的上

达到了475亿元。

但成本上涨也在侵蚀企业利润空间。小米集团在财报中表示，小米智能手机毛利率由2023年第三季度的16.6%减少至2024年第三季度的11.7%，主要是由于核心零部件价格上升及竞争加剧所致。

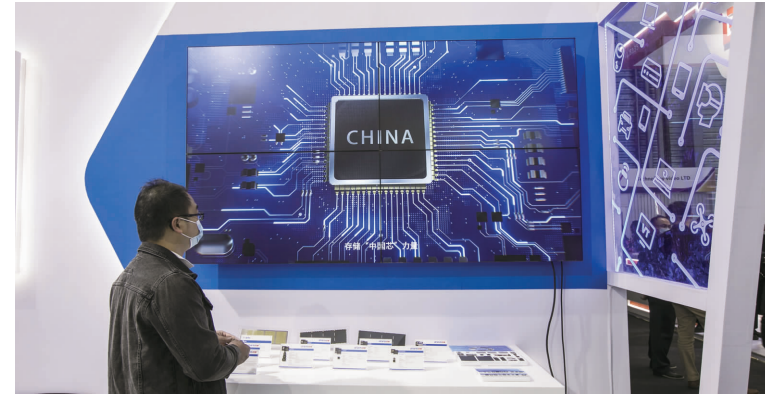
谈及智能手机毛利率的波动，小米集团合伙人、总裁卢伟冰也在财报电话会议上解释，这主要是因为第三季度内存价格比较高，以及产品发布周期对季度毛利率的影响。不过，卢伟冰也表示，目前手机业务毛利率在可控范围内。

事实上，不仅是小米集团，此前，专注海外中低端市场的传音控股（688036.SH）亦披露财报，公司第三季度公司实现营收166.93亿元，同比下降7.22%；净利润为10.51亿元，同比大幅下降41.02%。从毛利率来看，第三季度公司销售毛利率约为21.72%，同比下降3.49%。不过，单季毛利率环比提升0.83%。

涨趋势，加上HBM持续挤压整体DRAM产能，整体合约价在第三季度仍有8%至13%的涨幅。

“而在2024年第四季度，智能手机内存价格也开始出现季度环比下跌，其中，LPDDR4内存价格将季度环比下降8%~13%，LPDDR5内存价格将季度环比下降5%~10%，而到了2025年第一季度，由于未见到消费需求大回温，预测LPDDR4内存价格将季度环比下降8%~13%，LPDDR5内存价格将季度环比下降3%~8%。”吴雅婷表示。

eMMC和UFS被广泛用于手机、PC产品中。与此同时，关注闪存市场的TrendForce集邦咨询研究经理敖国锋也提到，以eMMC和UFS为主的闪存价格在第三季度出现季度合约价格环比持平，而预测2024年第四季度该品类闪存合约价格将季度环比下降8%~13%、



随着人工智能技术应用的不断推进，存储产品的价格每个季度都在创新高，给终端手机企业带来了更大的经营和成本压力。视觉中国/图

传音控股解释称，第三季度毛利率同比下滑主要受竞争格局、成本变动和公司价格策略等因素影响。而传音控股也提到，上游元器件的价格压力在减轻，一定程度上推动公司第三季度毛利率环比提升。

“手机市场在全年的总体出货量增长并不显著，大致维持在个位数百分比增长。然而，手机的存储配置随着闪存价格的波动而调整。高端智能手机市场正逐步采用UFS 4.0（具有高达1TB的存储容量）、LPDDR4（内存）和LPDDR5（内存）等更高性能的存储技术。由于存储容量的增加、UFS

4.0的成本相对较高也推高了整体闪存的成本。”慧荣科技CAS（终端与车用存储）业务群资深副总段喜亭对记者表示，从这一视角分析，高端智能手机的成本压力相对较大。相比之下，中低端手机市场受到的影响较小，这些手机主要采用UFS 2.2或eMMC作为存储解决方案，其存储容量通常不超过128GB或256GB，因此受到价格上涨压力的影响有限。然而，由于闪存价格的波动以及终端需求的变化，中低端手机的成本虽未受到前述因素的直接冲击，但仍受到库存压力的影响，也会有价格上的压力。

2025年第一季度合约价格会再环比下降5%~10%。

倪黄忠亦对记者指出，NAND Flash价格正出现下跌迹象，明年可能延续这一趋势，但这并不意味着原厂不赚钱，而是因为技术与效率提升，引发了产品价格下跌。随着NAND价格下探，手机市场可以更游刃有余地备货，放心大胆地布局产品，这对手机厂商而言，是一个发展机遇，尤其是高端手机市场。

不过，到了2025年第三季度，敖国锋预计，闪存价格有望再度反弹。敖国锋表示：“在2024年第四季度以及2025年第一季度市场处于供过于求，PC、智能手机2025年需求不明朗的情况下，几乎每家供应商都在节制资本支出，甚至考虑缩减明年的投产规模，减少明年的供给，待库存去化之后，

2025年下半年有机会出现随着需求的回升而带动闪存价格上涨的情况。”

段喜亭表示，当前，人工智能（AI）技术而更换手机的需求尚未被激发，因此大多数更换手机的需求并非由AI技术驱动，而是因为新款手机的发布或个人的实际需求。

“尽管当下AI Agent（AI智能体）整合得不是很好，但期待它在明年，尤其是明年下半年，将触发手机行业迎来一波正增长。”不过，段喜亭看好近期各家手机厂商落地的AI Agent发展。

集邦咨询资深研究副经理郭祚荣则认为，2025年AI Agent在智能手机上的落地发展值得关注，但AI手机带动市场较大增量可能要等到2026年，当前大家仍还在探索AI手机的应用在哪里。

三星半导体变阵：关键岗位洗牌以应对挑战

本报记者 吴清 北京报道

三星电子11月27日宣布了一系列管理层变动，主要涉及半导体业务部门。

《中国经营报》记者随后向三星电子方面确认相关消息，半导体业务部门是三星的核心部门，是公司的营收和利润主力军。此次人事调整涉及其半导体业务的内存、代工和系统LSI等核心领域的关键岗位调整，因此引发业内广泛关注。

三星电子方面表示，这些调整将有助于公司在全球半导体市场中保持领先地位，并推动公司的长期可持续发展。业内人士认为，这些人事变动反映了三星电子对半导体业务的重视，以及对未来技术和市场趋势的前瞻性布局。

记者梳理三星近些年的人事布局调整后发现，三星集团实际控制人，三星电子会长李在镕于2022年10月正式入主三星以来，三星基本在每年的年底都会进行规模化的人事布局调整。此前三星电子方面曾称，公司要通过任用年轻领导和技术人才，加快高管更新换代的步伐。一位接近三星的人士李荣彬向记者表示，此次调整基本延续三星此前年底重大人事调整的思路，提拔人才和推动管理团队年轻化。现在三星的半导体业务全球排名第二，不过正面临激烈的竞争，三星需要一个更年轻和强有力的管理团队，让外界看到其变化和竞争力。

半导体部门人事变阵

此次人事调整，主要集中在公司核心业务部门半导体业务部。

具体而言，据消息人士透露，三星电子副董事长全永铉（Jun Young-Hyun）将不再担任半导体业务设备解决方案（DS）部门负责人，而是晋升为首席执行官，使他能够直接监督该部门的日常运作。

负责管理半导体业务的三星设备解决方案（DS）三星美国半导体业务执行副总裁韩进万（Han Jin-man）可能会被提名负责新的内存业务负责人，领导三星的高带宽内存（HBM）芯片

重塑竞争力和形象

实际上，在全球各国和地区都在重金发力半导体业务之际，半导体巨头之间的竞争也愈发激烈。

今年7月至9月，三星的半导体业务利润环比下滑40%，而该公司的主要竞争对手台积电和SK海力士在人工智能热潮的推动下，均公布了创纪录的第三季度业绩。

在第三季度财报公布之际，全永铉称，三星电子与一家未具名大客户的人工智能芯片订单被延迟了，这拖累了业绩表现。自去年8月以来，这家科技巨

业务。

业内人士认为，高带宽内存（HBM）芯片业务近年来伴随AI的迭代发展而异军突起，韩进万在DRAM和闪存设计领域有着深厚的背景，并曾负责SSD的开发和策略营销，三星需要强化这方面的投入，以赶上另一家韩国半导体巨头SK海力士（该领域全球第一）。

而DS部门制造和技术总裁南锡宇（Nam Seok-woo）有望担任新任晶圆代工业务负责人，其在存储器技术和晶圆代工制造技术方面拥有丰富的经验，主要负责缩小三星与晶圆代工全球领导

者的台积电之间的差距。据悉，这几位半导体部门的高管被赋予更大的责任，反映出三星电子希望尽快扭转上述领域需求下滑、被动应对的局面。

尽管在3纳米工艺上遭遇了挑战，但三星代工部门Samsung Foundry正在积极推进其2纳米工艺技术的研发，以期在2纳米和1.4纳米节点的半导体竞赛中取得领先。

“此次主要调整的上述几个领域，都是目前全球半导体巨头竞相发力、竞争很激烈的关键领域，也是接下来三星半导体业务的发力重点。”李荣彬向

记者表示，此次人事调整表达了三星对这些领域的重视和发展决心。

智能手机、家电业务负责人韩钟熙则将留任。上述消息人士称，负责监督三星智能手机和消费电子业务的设备体验（DX）部门副董事长兼负责人韩钟熙将继续担任该业务的第一部分。但预计他将数字家电（DA）业务的控制权移交给明星副总裁兼DA开发团队负责人文钟承（Moon Jong-seung）。

上述消息人士还称，移动体验（MX）部门负责人卢泰文（TM Roh）和视觉显示（VD）部门总裁

兼负责人杨锡宇（Yong Seok-woo）可能会保留原有职位。三星业务支持工作组副主席郑贤浩（Jeong Hyeon-ho）可能会保留原有职位。三星显示器公司和三星电机公司负责人也有望保留原有职位。

不过，其他关键职位预计将发生重大变化，例如全球营销和北美业务、未来事业部的负责人。

值得注意的是，今年5月，三星半导体部门刚刚经历了一次“换将”，当时全永铉被任命为半导体部门的新负责人，该公司称此举是为了应对行业愈发激烈的市场竞争。

此外，韩国财政部近日表示，计划明年推出14万亿韩元（约合100亿美元）的低息贷款，以支持其芯片产业。韩国还寻求加大芯片公司的税收减免力度，并计划到2030年投资4万亿韩元，创建人工智能（AI）计算中心。“三星近期的一系列调整和举措，都清晰指向了公司业务核心中的核心半导体部门，强化竞争力、提升业绩，重塑一个更有活力和竞争力的形象都是三星想要和正在做的。”李荣彬表示。

作频频。

日前有消息称，三星电子在3D NAND闪存方面取得重大突破，成功减少了3D NAND光刻过程中的光刻胶（PR）用量，降幅达50%，预计三星每年将可从中节省数百亿韩元。

而据Business Korea报道，三星电子正在扩大国内外投资，在扩建其位于韩国忠清南道的半导体封装工厂的同时，将扩大苏州先进封装工厂产能，苏州工厂是三星唯一的海外测试与封装生产基地，此举意在强化其先进半导

体封装业务。

此外，韩国财政部近日表示，计划明年推出14万亿韩元（约合100亿美元）的低息贷款，以支持其芯片产业。韩国还寻求加大芯片公司的税收减免力度，并计划到2030年投资4万亿韩元，创建人工智能（AI）计算中心。“三星近期的一系列调整和举措，都清晰指向了公司业务核心中的核心半导体部门，强化竞争力、提升业绩，重塑一个更有活力和竞争力的形象都是三星想要和正在做的。”李荣彬表示。